



Title of Change:	CS517x datasheet correction on Lead Soldering Temperature
Effective date:	04 Mar 2020
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or cris.magpantay@onsemi.com
Type of notification:	This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.
Change Category:	Datasheet Specification Change
Change Sub-Category(s):	Datasheet/Product Doc change

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
None	None

Description and Purpose:

ON Semiconductor is notifying customers about a Datasheet correction for device CS517x device family.

The maximum soldering temperature will be corrected from 230°C to 260°C in compliant to device's Pb-free lead finish. There is no change in existing Bill of Materials

There is no change to form, fit, or function of the affected device.

Changes on the datasheet will reflect as follows

FROM:**MAXIMUM RATINGS**

Rating	Value	Unit
Junction Temperature Range, T _J	-40 to +150	°C
Storage Temperature Range, T _{STORAGE}	-65 to +150	°C
Package Thermal Resistance, Junction-to-Case, R _{θJC}	45	°C/W
	165	°C/W
Lead Temperature Soldering: Reflow (Note 1)	230 Peak	°C
ESD, Human Body Model	1.2	kV

TO:**MAXIMUM RATINGS**

Rating	Value	Unit
Junction Temperature Range, T _J	-40 to +150	°C
Storage Temperature Range, T _{STORAGE}	-65 to +150	°C
Package Thermal Resistance, Junction-to-Case, R _{θJC}	45	°C/W
	165	°C/W
Solder Reflow Temperature (Note 1)	260 Peak	°C
ESD, Human Body Model	1.2	kV

**List of Affected Standard Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

CS5171EDR8G	CS5171GDR8G	CS5172EDR8G
CS5173EDR8G	CS5173GDR8G	

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	CS517x データシートの鉛はんだ付け温度の修正	
発効日:	4 March 2020	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <cris.magpantay@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	本製品速報は通知目的のみのものです。オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。	
変更カテゴリ:	データシートの仕様変更	
変更サブカテゴリ:	データシート/製品資料の変更	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場 / 下請業者拠点: なし

説明および目的:

オン・セミコンダクターは、CS517x の製品ファミリーのデータシートの修正をお客様にお知らせします。
鉛フリーのリード仕上げに準拠して、最大はんだ付け温度が 230°C から 260°C に修正されます。
既存の部品表に変更はありません。
対象製品の形状、適合性、または機能に変更はありません。

データシートの変更は以下の内容を反映します。

FROM:

MAXIMUM RATINGS

Rating	Value	Unit
Junction Temperature Range, T _J	-40 to +150	°C
Storage Temperature Range, T _{STORAGE}	-65 to +150	°C
Package Thermal Resistance, Junction-to-Case, R _{θJC}	45	°C/W
	165	°C/W
Lead Temperature Soldering: Reflow (Note 1)	230 Peak	°C
ESD, Human Body Model	1.2	kV

TO:

MAXIMUM RATINGS

Rating	Value	Unit
Junction Temperature Range, T _J	-40 to +150	°C
Storage Temperature Range, T _{STORAGE}	-65 to +150	°C
Package Thermal Resistance, Junction-to-Case, R _{θJC}	45	°C/W
	165	°C/W
Solder Reflow Temperature (Note 1)	260 Peak	°C
ESD, Human Body Model	1.2	kV

影響を受ける部品の一覧:

注: 標準の部品番号(既製品)のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールの顧客の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

CS5171EDR8G	CS5171GDR8G	CS5172EDR8G
CS5173EDR8G	CS5173GDR8G	